

2026年3月期 第3四半期 決算説明資料



日本高純度化学株式会社

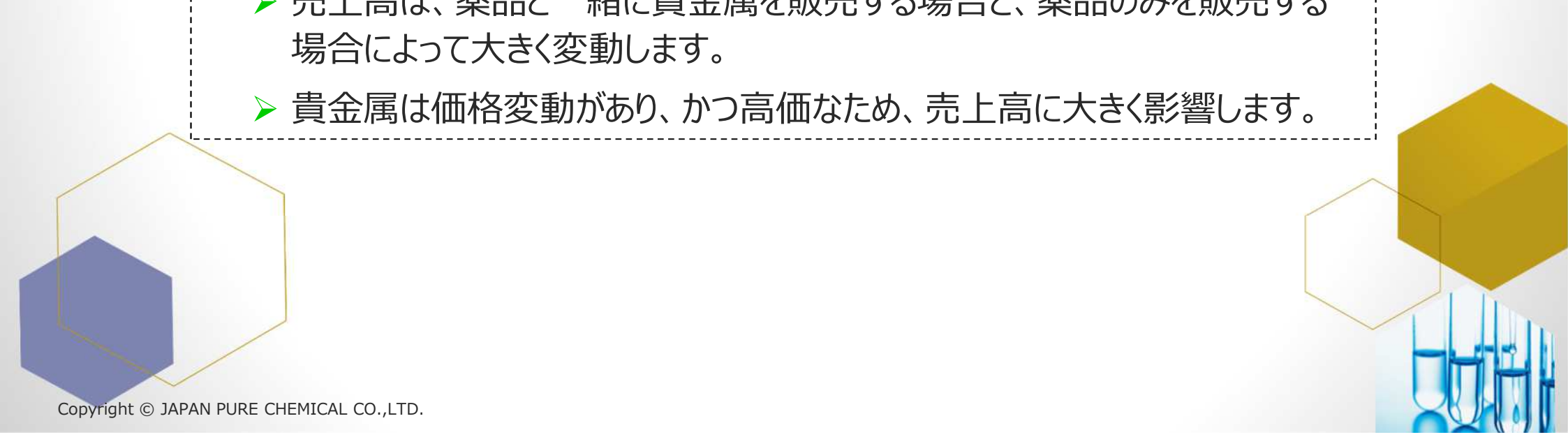
証券コード：4973

2026年1月26日



決算の概況

(注) 当社業績の見方のポイント

- 売上高は、薬品と一緒に貴金属を販売する場合と、薬品のみを販売する場合によって大きく変動します。
 - 貴金属は価格変動があり、かつ高価なため、売上高に大きく影響します。
- 

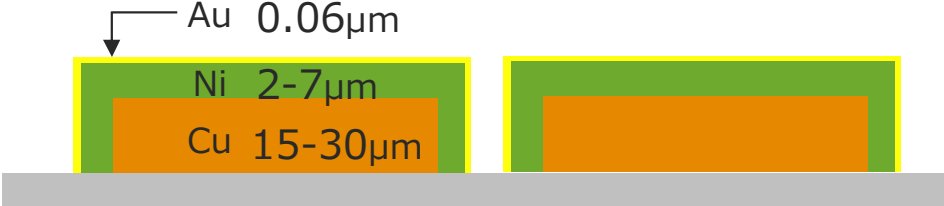
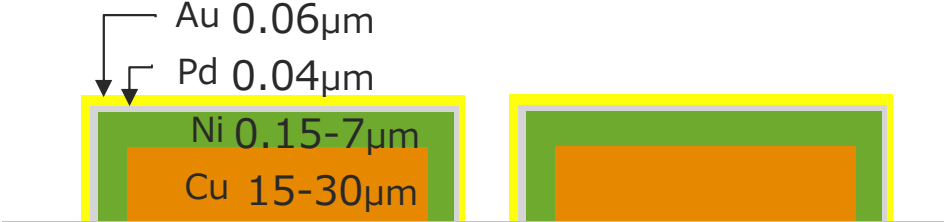

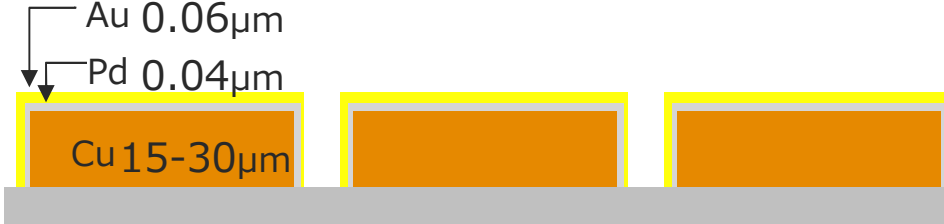
めっき方式の説明

用語	最終用途	説明
電解めっき	—	金属などの表面に電気を流してめっきする方法
純金めっき	PC・スマホ等のプリント基板（CPU・GPU等）	高純度な純金めっき
硬質金めっき	スマートフォン・車載・産業機械等のコネクタ	合金成分を入れて硬くした合金めっき
パラジウムめっき	PC・車載・産業機械等のリードフレーム	金めっきの下地めっきとして使用される
無電解めっき	—	電気を流さず化学反応によりめっきする方法
置換金めっき	DRAM・NAND等の半導体メモリ サーバー・PC・スマートフォン等の半導体搭載基板	金属ごとの溶けやすさ（イオン化傾向）を利用し、下地金属の表面を置き換えて形成するめっき方法
還元金めっき	半導体搭載基板 サーバー・PC等のCPU・GPU等	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法
還元パラジウムめっき	サーバー・PC等の半導体搭載基板	還元剤による化学反応を利用し、厚く形成できるめっき方法（金めっきの下地として使用される）

製品ラインアップ

めっき方式		用途	製品ラインアップ	
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき	テンペレジストシリーズ
	硬質金		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき	オーロブライト BAR7
	パラジウム		PPF用薄膜パラジウムめっき (PPF: Pre Plated Lead frame)	パラブライト NANO2
無電解	置換金		中～高リンニッケルで使える置換金めっき 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき ニッケル不使用置換金めっき	IM-GOLD IB2X IM-GOLD CN IM-GOLD PC
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき シアン化金を使った薄膜還元金めっき	HY-GOLD HY-GOLD CN
	還元パラジウム		ENEPIG用還元パラジウムめっき ニッケル不使用還元パラジウムめっき	ネオパラブライト 2 ネオパラブライト DP
周辺分野			卑金属（銅、スズ、ニッケル）、合金めっき、後処理剤など	

めっきプロセスの説明

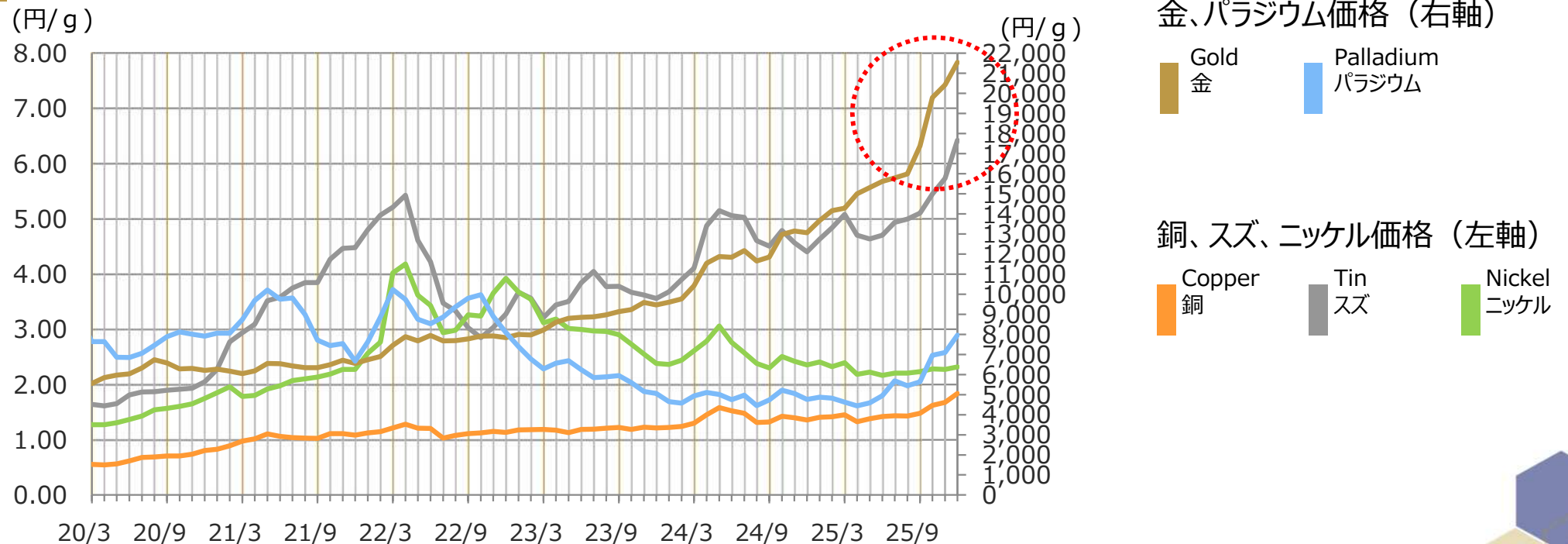
用語	説明	めっき層構成
ENIG	銅上に無電解ニッケルめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Ni-Au Electroless Nickel Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06µm Ni 2-7µm Cu 15-30µm</p>
ENEPIG	銅上に無電解ニッケルめっき、無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法 薄ニッケル化の動きが進んでいる。 層構成はCu-Ni-Pd-Au Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06µm Pd 0.04µm Ni 0.15-7µm Cu 15-30µm</p>
DIG	銅上に置換金めっきを直接する方法。Niめっきを省いているためENIGに比べファインピッチ対応が可能。 層構成はCu-Au Direct Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06µm Cu 15-30µm</p>
EPIG	銅上に無電解パラジウムめっき及び置換金めっきをする方法。 層構成はCu-Pd-Au Electroless Palladium Immersion Goldの略	 <p>Au 0.06µm Pd 0.04µm Cu 15-30µm</p>

2026年3月期 第3四半期外部環境

電子部品業界の状況

- AI向けインフラ需要の拡大を背景に、AIサーバー、データセンター向けは引き続き好調に推移。一方、パソコン向けは着実な需要回復がみられたが、スマートフォンなど民生機器向けならびにFA機器などの産業機器向けは緩やかな需要回復にとどまる。
- 車載用電子部品は、先進運転支援システムやコネクテッド機能の普及による需要の下支えはあるものの、米国の関税措置や欧米における電気自動車政策の見直しの影響を受け、需要の伸びは限定的となった。

貴金属の概況



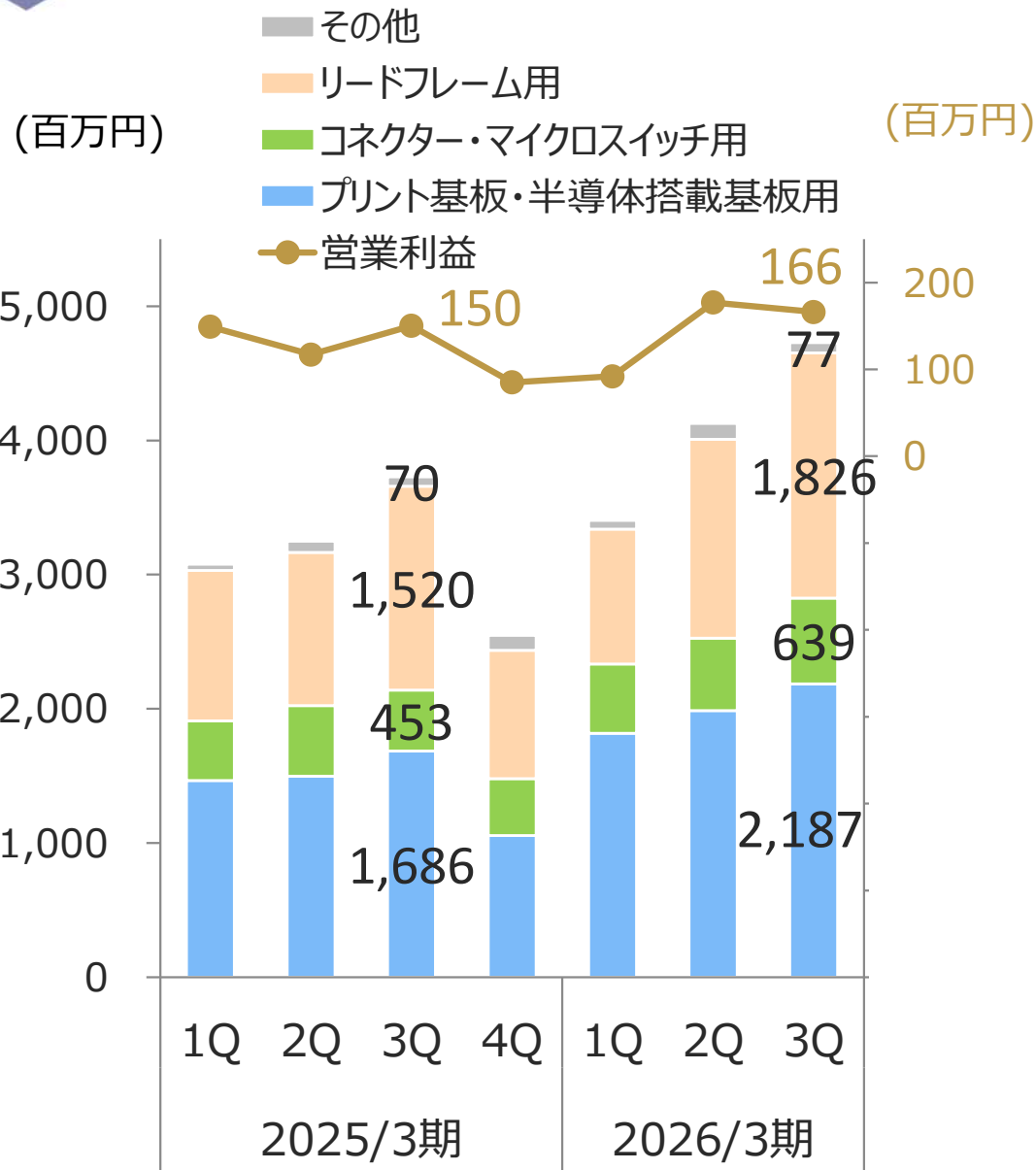
2026年3月期 第3四半期決算概況（累計）

当社の決算概況：増収増益

- 売上高：スマートフォンやパソコンなど民生向け需要が回復基調で推移したことに加え、生成AI関連需要の拡大により、半導体パッケージ、モジュール、およびメモリ向けの販売が堅調に推移。また貴金属価格の上昇も加わり、前年比+21.9%の増収
- 営業利益：新規拡販・販売量増加により粗利は増加したものの、研究開発等への先行投資に伴い費用が増加。その結果、営業利益は前年同期比+4.8%の増益
- 四半期純利益：営業利益増に加え、政策保有株式の売却により前年同期比+7.7%の増益

(単位：百万円)	2025/3期	2026/3期					
	3Q累計	1Q	2Q	3Q	3Q累計	増減率	3Q進捗率 (10/24公表比)
売上高	10,061	3,406	4,129	4,730	12,267	+21.9%	87.6%
営業利益	417	92	178	166	437	+4.8%	85.8%
経常利益	563	184	193	242	620	+10.1%	92.6%
四半期純利益	1,331	135	489	810	1,434	+7.7%	98.9%
1株当たり 四半期純利益	230.83円	23.40円	84.60円	140.00円	248.10円	-	-

売上高・営業利益の推移

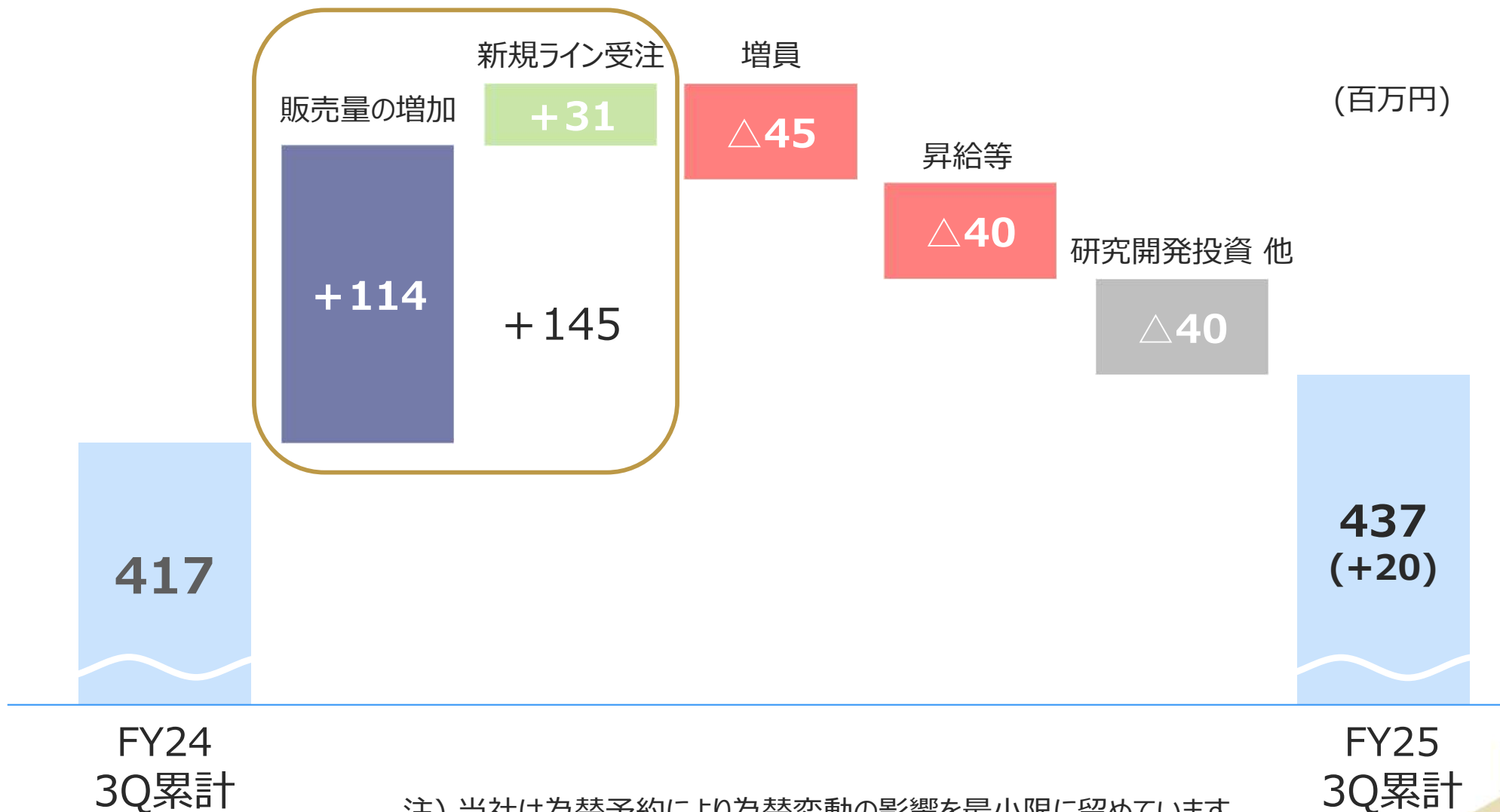


カテゴリー別概況（前年同四半期比）

- プリント基板・半導体搭載基板用めっき薬品
スマートフォンやパソコンなどの民生向けが回復してきたことに加え、生成AI関連の半導体パッケージ、光通信モジュール、およびメモリ向けが堅調に推移し増収
- コネクター用めっき薬品
車載向けで足踏み感が見られたが、スマートフォン向けや産業機器向けで回復してきたことで増収
- リードフレーム用めっき薬品
車載向けで低調に推移したが、民生向けで堅調に推移したうえ、貴金属価格の上昇も加わり増収

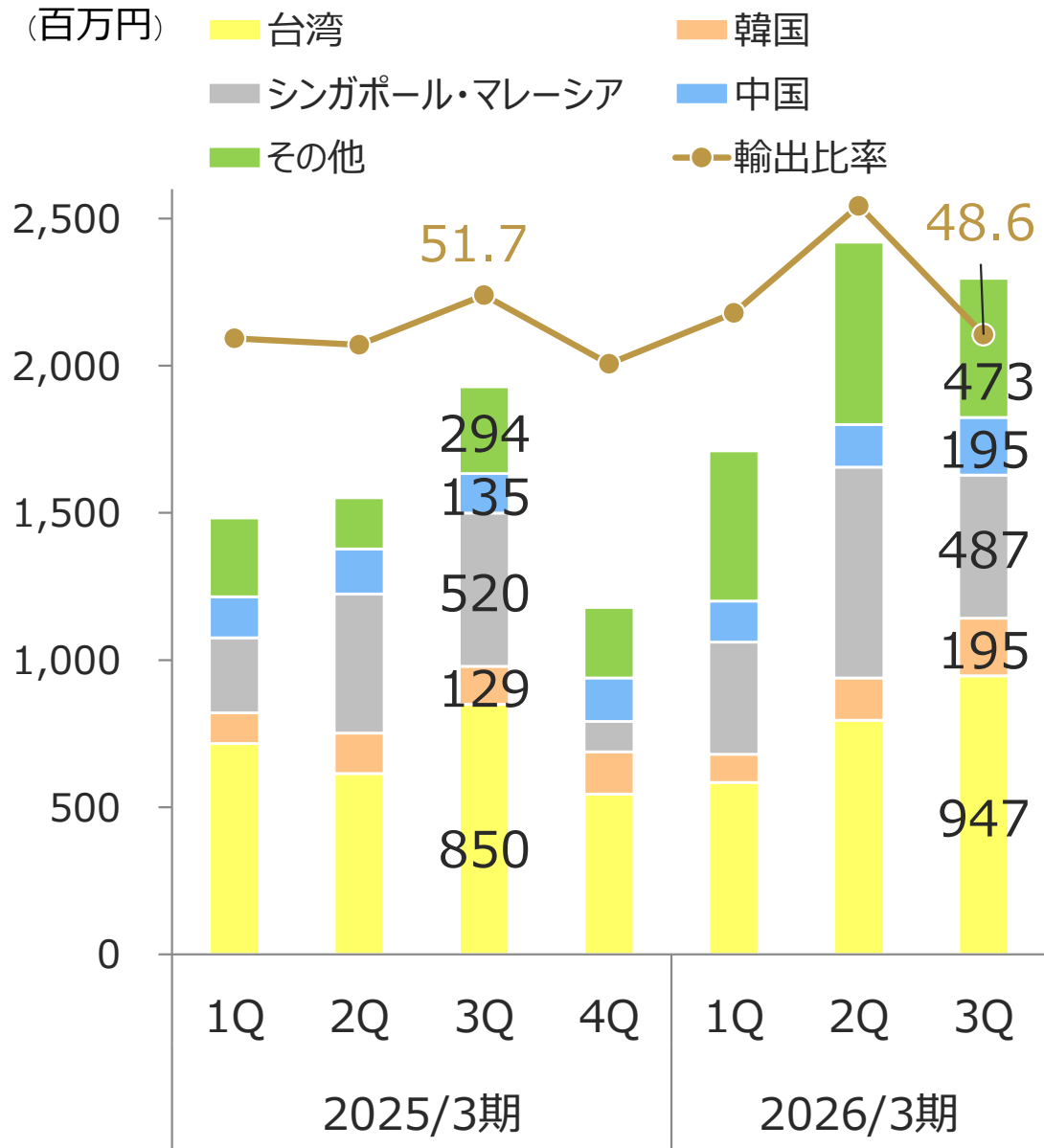
営業損益増減要因 (前年同期比)

- 需要回復にともなう販売量の増加に加え、新規ラインの受注拡大が増益に寄与
- 人的資本への先行投資の継続と研究開発投資による費用増を吸収し、増益を確保



注) 当社は為替予約により為替変動の影響を最小限に留めています。

輸出地域別売上高の推移（四半期ベース）



(%)

増減理由（前年同四半期比）

- 台湾
車載向けが在庫調整も、AIサーバ向け光通信モジュール、民生向けリードフレーム用途が堅調で増収
- シンガポール・マレーシア
顧客の一時的な在庫調整により減収
- その他
フィリピンにおけるパソコン/サーバ向けパッケージ用途の需要増

2026年3月期 見通し

- サーバ／データセンター向けは、AI向けインフラ需要の拡大を背景に好調な推移を予想
- 車載向けは電気自動車の需要鈍化による在庫調整長期化の懸念あり
- 直近の業績や貴金属価格の変動を勘案し、売上高や利益に関する通期見通しを修正
- 追加的な政策保有株式の売却を織り込む
- 政策保有株式の売却の進捗を踏まえ、期末配当予想を1株あたり74円増額の137円、年間配当予想を1株あたり200円に見直す

[中期経営計画に沿った政策保有株式の縮減に合わせて、今後も機動的な株主還元を継続予定]

(単位：百万円)	2025/3期	2026/3期	前期比	
			前期比	10/24 公表比
売上高	12,611	17,500	+38.8%	+25.0%
営業利益	502	540	+7.4%	+5.9%
経常利益	657	730	+11.0%	+9.0%
投資有価証券売却益	1,512	1,650	+9.1%	+22.2%
当期純利益	1,579	1,750	+10.8%	+20.7%
1株あたり配当	126円	200円	+74円	+74円
ROE	11.3%	10.6%	—	—

政策保有株式売却の進捗

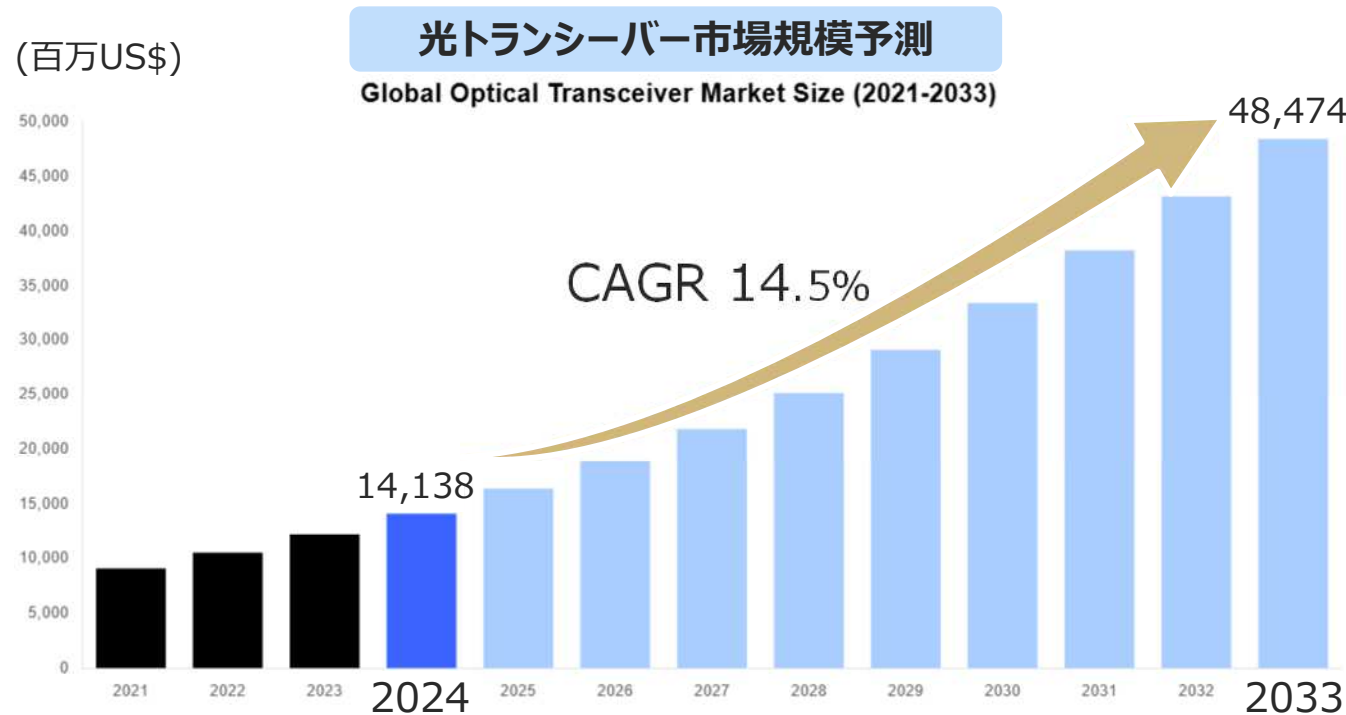
- 当社は政策保有株式について、中期経営計画 FY2025-2027の期間中に純資産割合を20%未満に縮減する方針を掲げています。
- 2025年10月24日公表の「(開示事項の経過)投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ」に沿って進めていた株式売却が予定通り完了しました。
- 市場の動向を踏まえて、追加的な売却を実施します。

	2024年 12月末	2025年 3月末	2025年 6月末	2025年 9月末	2025年 12月末
売却額 ※ (百万円)	553	275	—	493	933
保有株式時価 (百万円)	7,108	5,974	6,740	8,416	9,308
純資産額 (百万円)	14,149	13,594	13,891	15,566	16,659
純資産に対する割合 (%)	50.2	43.9	48.5	54.1	55.9

※ 該当四半期中での売却額

トピックス：光トランシーバー用途で広がる当社の成長機会

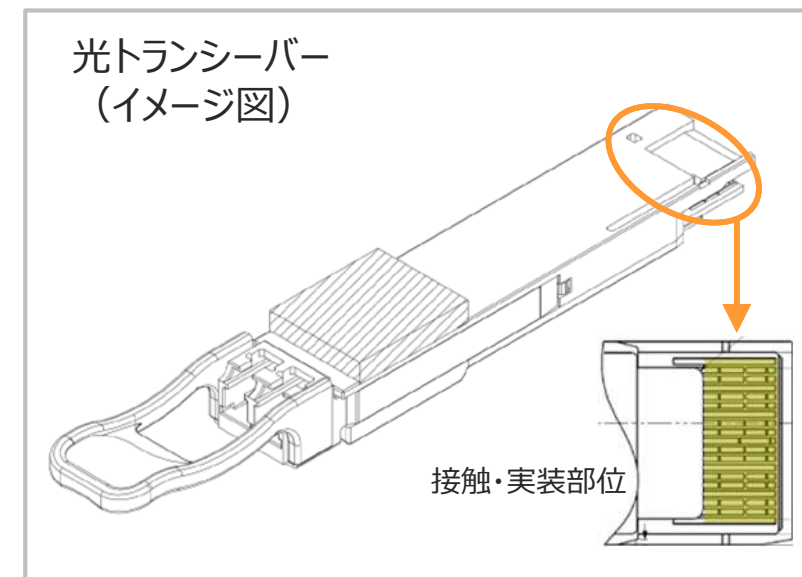
- AIサーバー用の光トランシーバーには長期安定動作のため高信頼性が求められており、当社が長年強みとしてきたPd（パラジウム）の無電解めっき技術が業界標準として認知されつつあり、商談・採用が拡大中
- 無電解Pdめっき技術を当社のコアコンピタンスとして強化し、拡大が続くAIサーバー市場の需要を取り込み、持続的なシェア拡大を図る



出典：Straits Research Analysis

https://straitsresearch.com/vertex/insights/optical-transceiver-market/global?utm_source=chatgpt.com

コネクタ部を中心に無電解めっき技術が多用



出典：QSFP-DD-Hardware-Rev7.1
(P66,69より抜粋)

補足資料：会社紹介

沿革

- 1971年 7月 会社設立
- 1999年 11月 MBOを実施
- 2002年 12月 JASDAQ市場に上場
- 2004年 3月 東京証券取引所市場第二部に上場
- 2005年 3月 東京証券取引所市場第一部に上場
- 2019年 2月 一般財団法人JPC奨学財団設立
- 2020年 4月 公益財団法人JPC奨学財団に認定
- 2022年 4月 東京証券取引所プライム市場に移行

事業概要

- 電子部品業界の発展を支える電子材料を供給するファインケミカル企業
- 事業のターゲットを貴金属めっき薬品に絞り世界シェアトップクラス
- 変化の激しい業界にスピーディーに対応できる販売体制と技術サポート体制を構築
- 大規模な製造プラントを保有しないファブライツ企業
- 電子部品の接続に用いる貴金属の使用量を最小限に抑える技術を提供し、資源の有効利用に貢献



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2025年12月末時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>